

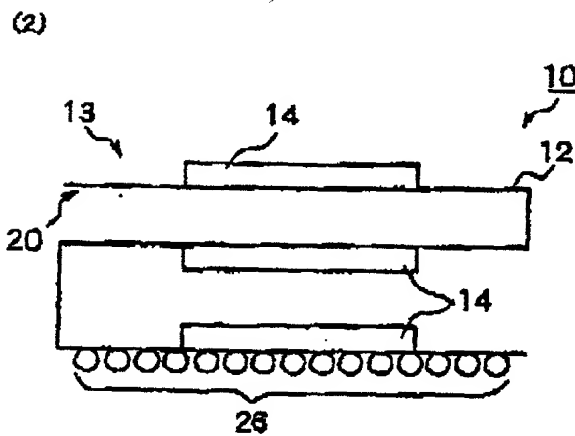
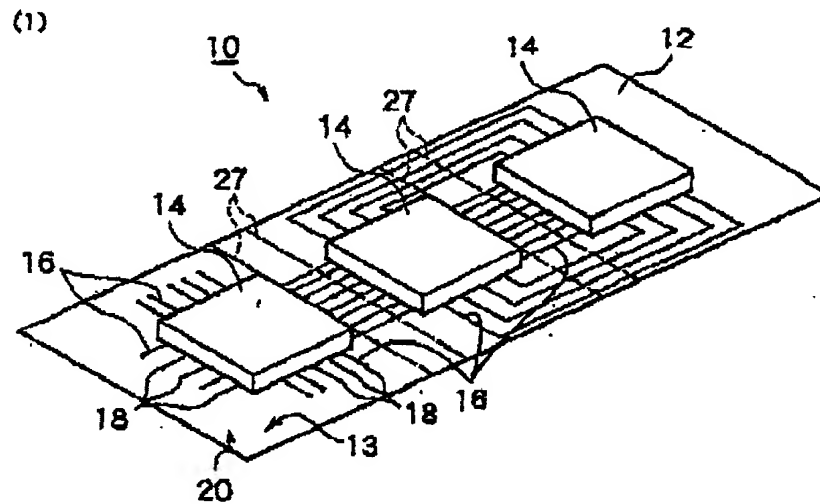
整理番号=J0074549

提出日 平成12年 1月12日

頁: 1/ 5

【書類名】 図面

【図1】



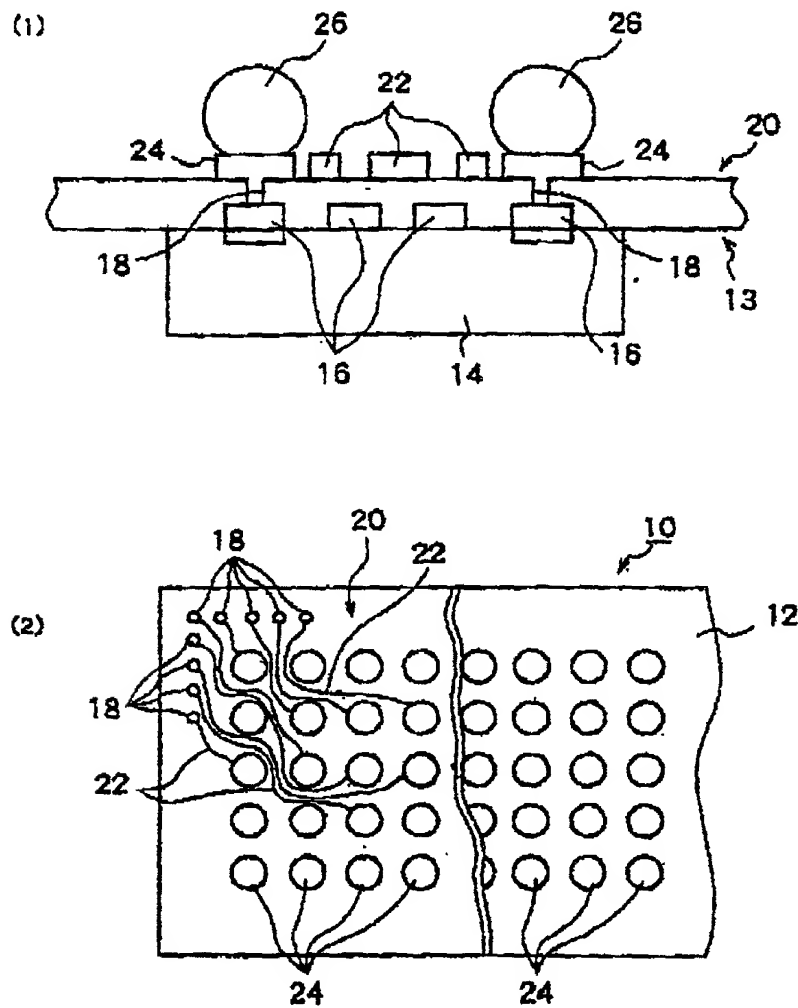
10: SEMICONDUCTOR DEVICE
12: CONNECTION SUBSTRATE
14: SEMICONDUCTOR CHIP
16: 1st METALLIC WIRING

整理番号=J 0 0 7 4 5 4 9

提出日 平成12年 1月12日

頁: 2/ 5

【図2】

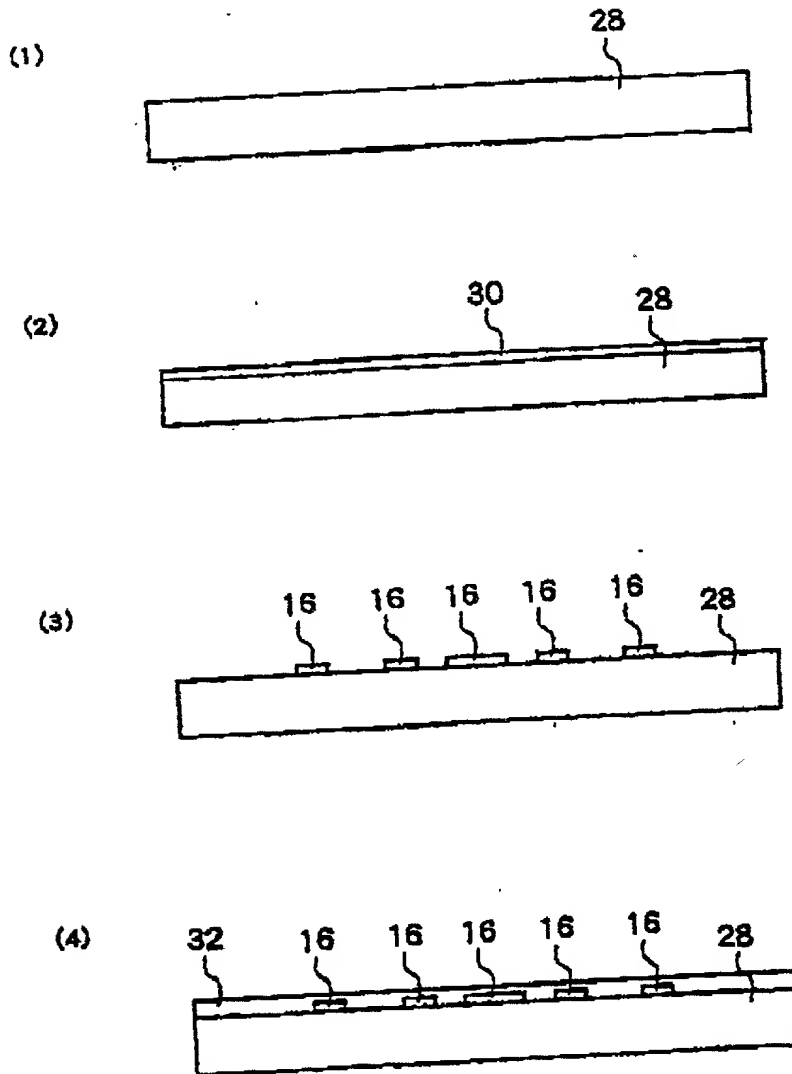


提出日 平成12年 1月12日

頁: 3/ 5

整理番号=J0074549

【図3】

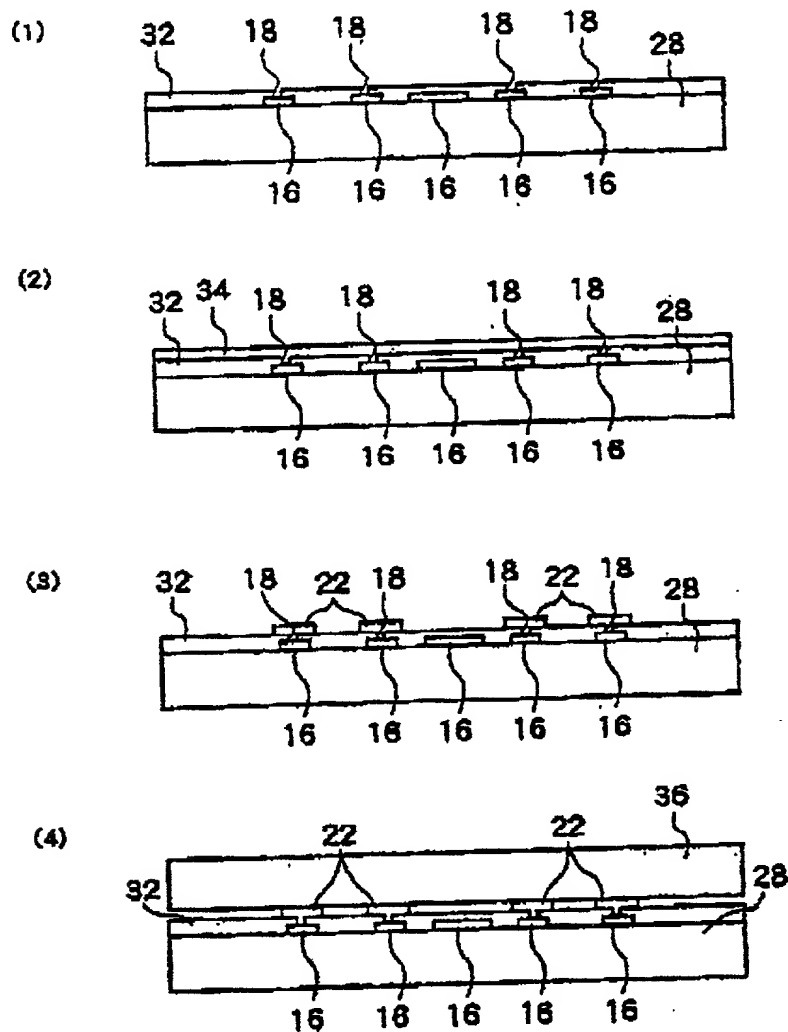


提出日 平成12年 1月12日

整理番号=J0074549

頁: 4/ 5

【図4】



提出日 平成12年 1月12日
頁: 5/ 6

整理番号=J0074549

【図5】

